研究トピックス



人工材料・複合材料を用いた 電磁メタマテリアルの開発

Development of electromagnetic metamaterials by use of artificial and granular composite materials

広島大学大学院教育学研究科 蔦岡 孝則 〒739-78524 広島県東広島市鏡山 1-1-1, e-mail: tsutaok@hiroshima-u.ac.jp

1. はじめに

ラジオ波帯(RF)からミリ波,及び赤外から可視光 領域における電磁場制御を目的として,これらの周波 数領域で負の誘電率 (ENG: Epsilon Negative),あるい は負の透磁率 (MNG: Mu Negative)を有する材料 (SNG: Single Negative),及びこれらを組み合わせて特 定の周波数領域で同時に負の誘電率と透磁率(DNG: Double Negative)を実現する材料(電磁メタマテリアル) が注目され、多くの研究がなされている。中でも、RF 帯からマイクロ波の領域においては、電磁遮蔽や電波 吸収をはじめとする電磁環境技術(EMC技術)への 応用を目指して、これらメタマテリアルを用いた周波 数選択遮蔽や電波吸収体の超広帯域化、さらには超薄 型構造で完全電波吸収体や空間フィルターを実現する メタ表面 (Meta -surface)技術が検討されている[1-5]。

本稿では、電磁メタマテリアルの概要と、人工材料及 び粒子分散型複合材料を用いた SNG・DNG メタマテ リアルの電磁気特性について述べる。

2. 電磁メタマテリアル

空気中や各種誘電体・磁性体中を伝搬する電磁波の伝 搬特性(位相や振幅,速度等)は,これら材料(媒質)の誘 電率・透磁率によって決定される。媒質の誘電率・透磁率 を,真空中の値で規格化した複素比誘電率 $\epsilon_r = \epsilon_r' - j\epsilon_r''$ と 複素比透磁率 $\mu_r = \mu_r' - j\mu_r''で表示すると,実数部(<math>\epsilon_r''$ と μ_r')が伝搬特性を,虚数部($\epsilon_r'' > \mu_r''$)が減衰特性を表す。 図1に示すように,媒質を $\epsilon_r > \mu_r$ (実部と考えて良い)の符 号で分類すると, $\epsilon_r > \mu_r$ が同符号のIとIII,及び異符号のII



図 1: 透磁率µと誘電率 € で分類した材料の電磁特性

とIVに分けられる[6]。媒質II, IVでは*ε*, 'あるいは*µ*,'の一 方が負であるため, 電磁波は減衰波(エバネセント波)とな り媒質中を伝搬しない。これらの媒質は自然界に存在し, 媒質IIは金属や, 電離層等のプラズマが, 媒質IVは強磁 性体の磁気共鳴周波数における負の透磁率が相当する。 媒質IIの金属線配列構造は負の誘電率を示す人工材料 の一種である[7]。媒質IVは金属パターンを用いたSplit Ring共振器で人工的に実現されている[6]。しかしながら, 同時に負の誘電率と透磁率を有する媒質IIIは自然界に は存在が知られていない。これら4つの状態の内, 電磁波 が伝搬可能なのは領域IとIIIであるが, 領域IIIは伝搬する 電磁波の位相速度が領域Iとは逆方向であり, このため負 の屈折率など特異な性質が得られる[6]。この特性は左手 系と呼ばれ、金属線配列材とSplit Ring共振器を組み合わせて負の屈折率特性が実証されている[6]。

3. 人工材料を用いた電磁メタマテリアル

3-1. 金属線配列構造による負の誘電率

金属細線を周期配列した構造体(Metal Wire Array)は, 負の誘電率特性(ENG)を有するメタマテリアルとなる [5]。金属線配列構造体は,金属細線を保持するために 誘電体フィルム等で挟んだ構造にするため,均一媒質 としてみた場合の誘電率,透磁率は誘電体フィルムの 効果を考慮する必要がある。

無限長金属線で近似できる長金属線配列構造は,図 2(b)に示すような,特定の周波数以下で誘電率の実数 部ɛ,'が負となるドルーデ(Drude)型の誘電率スペクトル を示す[7]。一方,虚数部はほぼゼロであり複素誘電率 は, *o*を角周波数とすると以下の式で記述できる。

$$\varepsilon_r = \varepsilon_r' - j\varepsilon_r'' = A \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right)$$
(1)

ここで、Aは定数、 a_p は等価プラズマ振動数で、金属細線の直径をd、中心間の距離をa、誘電体シートの厚みと誘電率をそれぞれb、 ϵ_m とすると、



クトル

$$\omega_{\rm p}^{\ 2} = \frac{1}{\varepsilon_{\rm m}b + d} \frac{2\pi c^2}{a} \frac{1}{\ln\left(\frac{a}{\pi d}\right)}$$
(2)

で与えられる[7]。

一方,短い金属線を等間隔に配置した短金属線配列 構造体は,外部電場によって金属線に誘起される分極 が特定の周波数で外部交番電場に共鳴するローレンツ (Lorentz)型の誘電率スペクトルを持ち,等価誘電率は 以下の式で近似できる[8]。

$$\varepsilon_r = \varepsilon_a + \frac{K}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\Gamma\omega} \tag{3}$$

ここで、 ε_a 、*K*は定数、 ω_0 は構造体の配列状態で決まる 共鳴角振動数、 Π はダンピング係数である。図3に短金 属線配列構造体と、測定及び(3)式を用いて近似した等 価誘電率スペクトルを示す[8]。図3(b)は、直径275 µm、 長さ25 mmの短金属線を40 mmの間隔で縦横に配列し た構造体の例であり、共鳴周波数 $f_0 = \omega_0/2\pi = 4.9$ GHz で虚数部 ε_i "がピークを取り、 $f_0 \sim 7$ GHzで実数部 ε_i " が負の値を取る。伝送線路理論では、これら金属線配 列構造体を含む金属パターンの周期配列構造は、線路 に並列にインダクタンス*L*が挿入される回路で表され、



図 3: 短金属線配列構造体の構造と等価誘電率スペ クトル

負の誘電率を持つ均一媒質として扱うことができる[5]。

3-2. 人工材料を用いた空間フィルター

金属パターンの EMC 技術への応用として,特定周波 数帯のみ電磁波を透過させる空間フィルターがある。 図 4 (a)は,ホールアレイと呼ばれる金属薄板 (厚み 0.012 mm) に等間隔で穴をあけた金属パターン構造体 (ホール半径 1.5 mm,中心間距離 10 mm) を誘電体で挟 んだメタマテリアル構造体であり,図に示すように, インダクタンス L とキャパシタンス C を線路に並列に 挿入した等価回路で表すことができる[5]。本構造体に 対するマイクロ波の透過・反射係数を図 4 (b)に示す[9]。 低周波領域では反射係数 Γ =1であり,電磁波は透過し ないが,約6~10 GHzの周波数領域で透過係数T=1 となり,電磁波が透過する空間フィルター特性が得ら れる。



図 4: ホールアレイ構造体とそれを用いた空間フィ ルターの反射,透過特性

4. 複合材料技術を用いたメタマテリアル

4-1. 金属粒子と強磁性粒子のハイブリッド構造

粒子分散型複合材料でDNG特性を実現する方法として、金属微粒子と磁性体微粒子を同時に絶縁体母材に 分散させたハイブリッド複合材料が検討されている [10-12]。図5にハイブリッド複合材料の構造を示す[11]。 図には, ENG とMNGの概念図も示している。金属粒



図 5: 粒子分散型複合材料による負の透磁率・誘電率 の発現機構

子濃度を増加させると粒子同士が接触してクラスター が形成される。この時、粒子クラスターの結合により 材料全体に電流経路が形成されるパーコレーション濃 度 *φ*以下では、電場が印加されると、孤立金属粒子あ るいは孤立クラスターに分極P誘起され、複合材料は誘 電的性質を示す。強磁性粒子は、絶縁体の場合には電 気的パーコレーションには関与せず、透磁率が磁性体 粒子濃度とともに増加してゆく。そして、高周波では、 磁気共鳴により透磁率に正、あるいは負の周波数分散 が現れる。金属粒子濃度の増加によりハイブリッド複 合材料がパーコレート相に移行すると、電気的には金 属状態となる。しかしながら、電流は結合したクラス ターに沿ったいくつかの経路にしか流れないため、無 限長金属繊維の配列構造によるメタマテリアルと同様 の低周波プラズマ状態がランダムコンポジットで実現 できることとなる。この際、孤立した金属粒子クラス ターは、電気分極を持つので、誘電率には、ドルーデ 型のプラズマ振動による分散と、ローレンツ型の誘電 共鳴による分散とが重なったスペクトルが得られる。 それゆえ、特性周波数以下でハイブリッド材料の誘電 率実数部が負となるENG特性が実現できる。そして、 この状態で、強磁性体微粒子が磁気共鳴による負の透 磁率(MNG)を持てば、前述のEMG特性との組み合わせ によりDNG複合材料が実現できる可能性がある。

4-2. 金属粒子のクラスター構造による負の誘電率





金属粒子のクラスター構造を利用したENG材料の例

として、直径 2~5 μ mの複合Cu粒子を樹脂中に分散さ せたCu複合材料について述べる[12]。図6は、複合Cu 粒子と 20 vol.%複合材料のSEM写真((a)と(b))、電気伝 導率のCu粒子濃度依存(c)、及びパーコレート相の誘電 率スペクトル(d)を示したものである。低濃度のCu複合 材料は、導電率が 10⁸ S/cmのオーダーの絶縁体である が、Cu粒子濃度が 15 vol.%付近で導電率は急激に増加 し 10⁻¹ S/cmのオーダーとなる。そして、16 vol.%以上で は負の誘電率を有するプラズマ媒質の性質を示し、周 波数分散特性はドルーデモデルで記述できる。図6(d) では、数GHzに誘電率の実数部が負から正に変わる特 性周波数 f_p が存在する。しかしながら、金属粒子複合材 料では、金属線配列構造体とは異なり、ジュール損失 が大きく媒質中での電磁波の減衰が顕著に表れる。

4-3. 金属/強磁性ハイブリッド構造による DNG

金属粒子と強磁性粒子のハイブリッド構造を用いた DNG複合材料の例として、CuとFeNi合金(Fe₅₃Ni₄₇)を PPS樹脂中に複合分散させたCu/FeNi ハイブリッド複 合材料の透磁率・誘電率スペクトルについて述べる。



図 7: Cu/FeNi 合金ハイブリッド複合材料の SEM 写真 (a),及び透磁率,誘電率スペクトル(DNG 特性)(b)

図 7 (a)にCu/FeNi 複合材料のSEM写真を示す。Cu粒 子, FeNi粒子, 及びPPS樹脂の体積分率 (Volume fraction) を添え字x, yで表し, (Cu_xFeNi_{1-x})_yPPS_{1-y}のように記述す る。図 7 (a)は,体積濃度がそれぞれx = 0.1, y =0.85 組 成の複合材料である。Cu/FeNi 複合材料は,FeNi合金 が金属であるため,Cu粒子とFeNi粒子が結合したクラ スター構造が電気的パーコレート相を形成する。同図 より,孤立したCu/FeNiクラスターと,パーコレートし たクラスターが共存しているのがわかる。

図7(b)は, x = 0.24 組成の複合材料における透磁率と 誘電率の実数部を示している。本Cu粒子濃度では, Cu/FeNi複合粒子がパーコレート相を構成し,電気伝導 率は2.1 S/cmであり,低周波プラズマが形成されて誘 電率の実数部₆, が 3.5 GHz以下で負の値を取る[15]。ま た,透磁率の実数部µ, は,約 0.6~1.5GHzで負の値を とる。FeNi合金のジャイロ磁気共鳴はXバンドに存在 することが知られているので,負の透磁率は分散した マイクロ粒子内の磁区構造(磁壁共鳴)に起因すると 考えられる。これら2つの機構により透磁率が負とな る周波数範囲でDNG特性が得られる。。

5. おわりに

人工材料,及び複合材料技術を利用して,RF帯から マイクロ波領域で負の誘電率・透磁率スペクトルを有 する電磁メタマテリアルを構成する方法について述べ た。人工材料による電磁メタマテリアルは、マイクロ 波からミリ波領域で超薄型の電波吸収体や空間フィル ターを構成するメタ表面技術として実用化を目指して 現在活発に研究が進められている。一方,粒子分散型 複合材料を用いた電磁メタマテリアルを EMC 技術や 電子デバイスに応用するためには、ENG, MNG,及 びDNG スペクトルを制御するための材料パラメータ, 誘電損失,磁気損失,導電損失等の影響とその制御方 法の開発など,基礎的な物性研究が今後さらに必要で あると思われる。

参考文献

- T. Tsutaoka, K. Hatakeyama, *IEICE Transaction on Communications*, E93-B (7), (2010) 1858-1861.
- [2] C.M. Watts, X. Liu, W.J. Padilla, Advanced Materials, 24,

(2012) OP98-OP120.

- [3] N.L. Landy, S. Sajuyigbe, J.J. Mock, D.R. Smith, W.J. Padilla, *Physical Review Letters*, 100, (2008) 207402.
- [4] W. Fang, S. Xu, International Journal of Infrared and Millimeter Waves, 29, (2008) 799-807.
- [5] 畠山賢一, 蔦岡孝則, 電子情報通信学会論文誌 B, J100-B (3), (2017) 127-137.
- [6] C. Caloz and T. Itoh, "*Electromagentic Metamaterials*" Johm Wiely&Sons, (2006) 1.
- [7] 畠山賢一, 蔦岡孝則, 兼本貴仁, 山本真一郎, 岩井
 通, 電子情報通信学会論文誌 B, J-93-B (1) (2010)
 101-111.
- [8] S. Yamamoto, K.Hatakeyama, T. Tsutaoka, Proc. IEEE Int. Symp. EMC, Denver, (2013) 557.
- [9] 藤井 渉,山本真一郎,畠山賢一,岩井 通,蔦岡 孝則,信学技報,EMCJ2016-56,(2016) 35.
- [10] B. Li, G. Sui, and W. H. Zhong, *Advanced Materials*, 21 (2009) 4176.
- [11] T. Tsutaoka, T. Kasagi, S.Yamamoto, K. Hatakeyama, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 383 (2015) 139.
- [12] T. Tsutaoka, K. Fukuyama, H. Kinoshita, T. Kasagi, S. Yamamoto, K. Hatakeyama, *Applied Physics Letters*, 103 (2013) 261906.
- [13] B. Li, G. Sui, and W. H. Zhong, Advanced Materials, 21 (2009) 4176.
- [14] Z. C. Shi et al., Advanced Materials, 24 (2013) 2349.
- [15] H. Massango, T. Tsutaoka, T. Kasagi, *Materials Research Express*, 3, (2016) 1.